

2026-2027年 米中次世代LLM覇権争い：構造的転換とブレイクスルーの行方

2026～2027年は「スケーリングの壁（データ枯渇・電力不足）」に直面し、AI進化の軸が事前学習から「推論時計算（TTC）」と「エージェント機能」へ移行する転換期です。米国は巨大資本による圧倒的インフラで、中国はアルゴリズムの極限効率化と国産半導体の垂直統合で対抗し、世界のAIEコシステムは二極化が進みます。

米国陣営：巨大資本とフロンティアモデルの追求



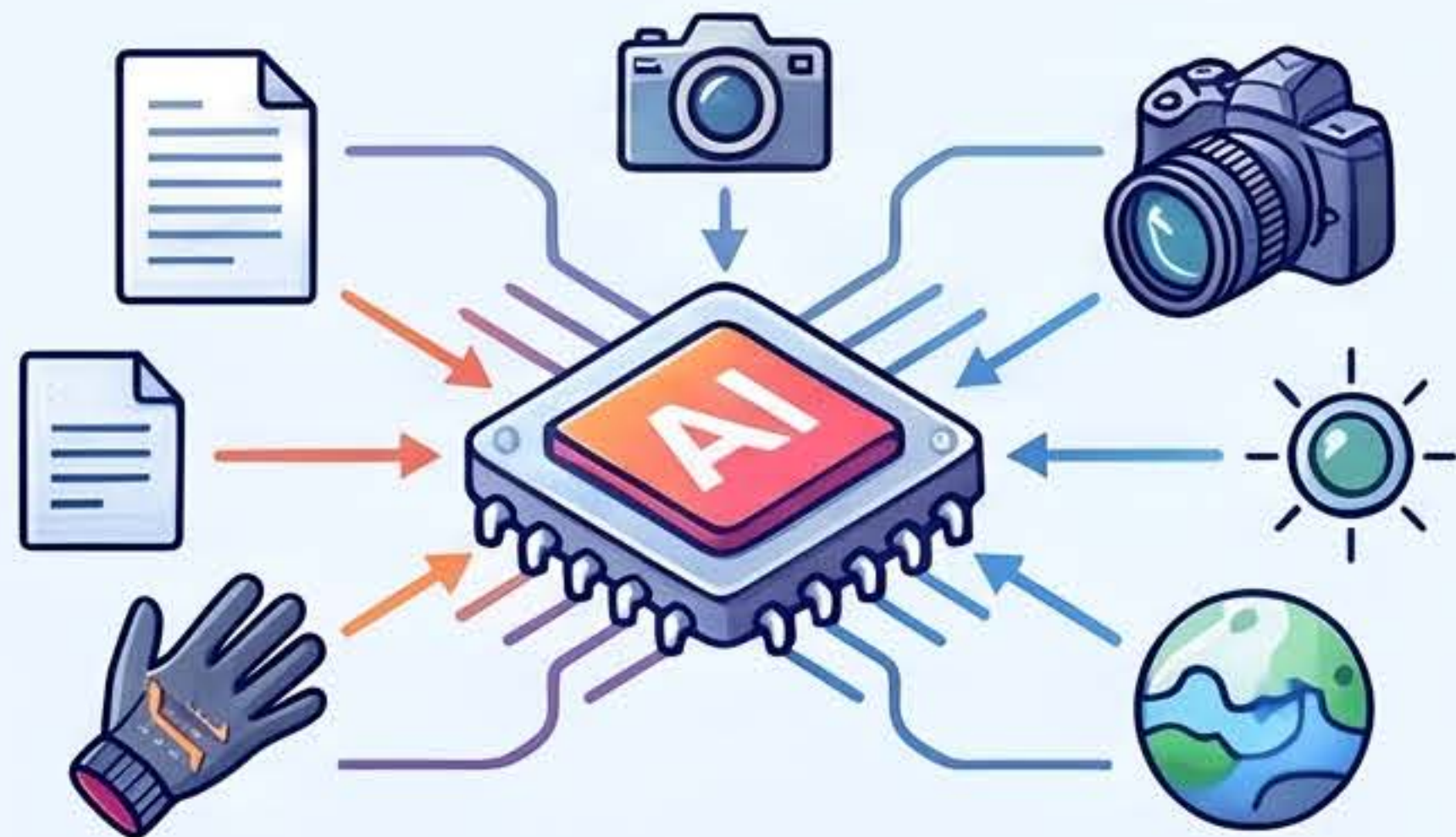
5GW超 Stargate インフラ

数十兆パラメータ規模のモデルを運用するため、ギガワット規模のデータセンターと原子力発電（SMR）を直接確保。



「持続的認知記憶」の獲得

GPT-6（Astra）世代では、セッションごとのリセットを脱し、ユーザーの長期的目標を自律的に学習・記憶する。



全モダリティのネイティブ統合

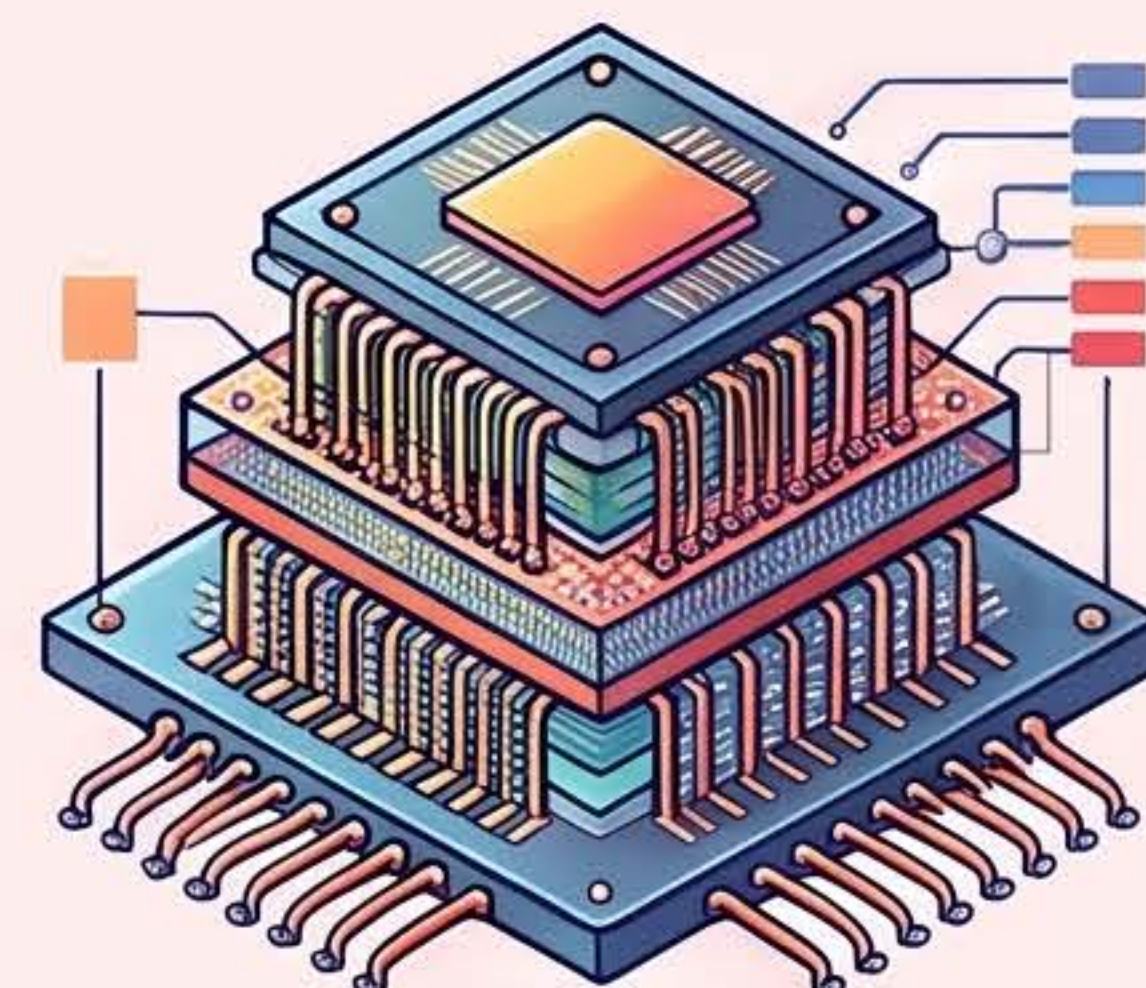
テキストや画像だけでなく、触覚や環境センサーを直接処理し、未解決の科学的問題を自律的に証明・解決する。

中国陣営：アルゴリズム効率化と独自エコシステム



オープンウェイトモデルの採用率

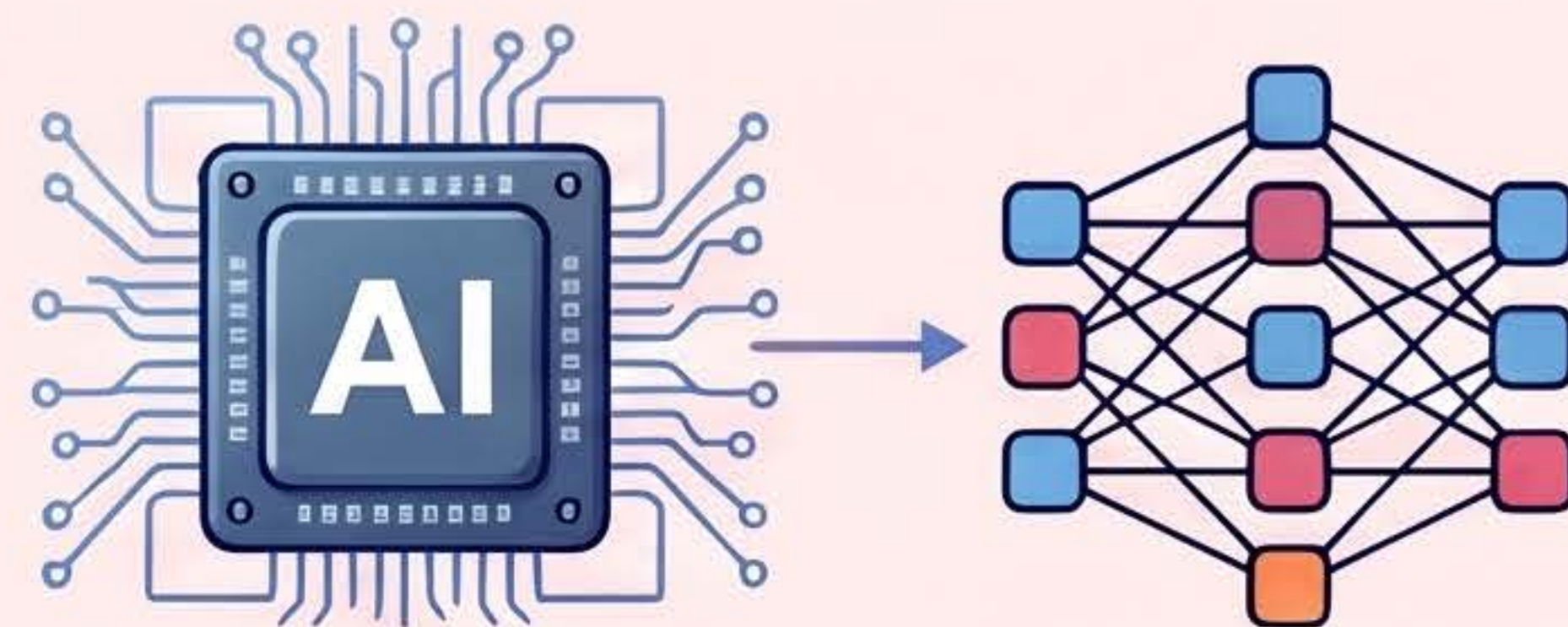
DeepSeekやQwen等の高性能・低コストな公開モデルが、2027年までにグローバル企業の過半数に採用される。



制約を突破する

「Tau Scaling Law」

半導体規制に対し、独自HBMと3Dパッケージングによる超高密度トポロジーで、システム全体の帯域幅を確保する。



Huawei Ascend 950PR

Sparse MoE

国産シリコンとの垂直統合

Huawei Ascend 950PR等の独自チップとモデル設計（Sparse MoE）を最適化し、米国の輸出規制品を凌駕する推論性能を実現。

主要戦略



閉鎖型・高機能
フロンティアモデル

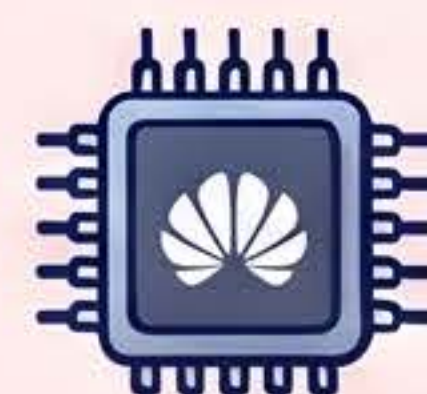


オープンウェイト・
圧倒的低コスト

基盤ハード



Nvidia Blackwell /
Google TPU

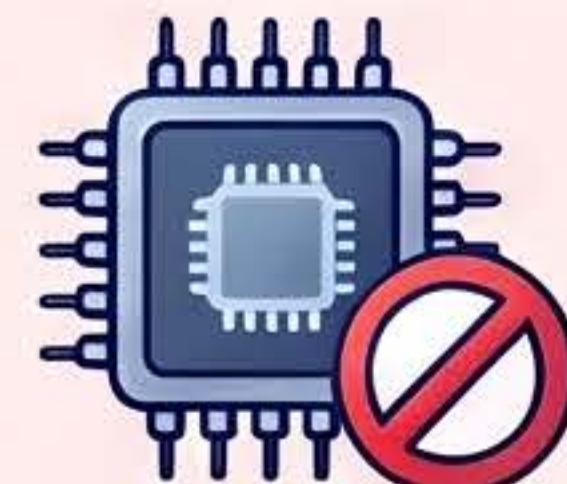


国産チップ (Local Chips)
自社設計シリコン

最大の制約



データセンターの
電力確保・系統接続



米国の輸出規制
(先進プロセス・HBM)